

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2026-007

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信。现将相关事宜公告如下：

一、向金融机构申请综合授信情况概述

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信（最终以实际审批的综合授信额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。授信期限为 1 年至 5 年（以银行批准的实际授信期限为准）。上述公司贷款可以公司及子公司（含孙公司）的自有资产进行抵押、质押担保。实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定（最终以金融机构与公司实际发生的融资金额为准）。

上述综合授信额度需提交 2026 年第一次临时股东会审议批准，股东会审议通过后，在综合授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司（含孙公司）办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。本次授信额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过此议案之日起至 2026 年年度股东会召开日止。2026 年第一次临时股东会通过后，公司原 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关

于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》不再执行，未尽事宜根据本次股东会决议予以承接。

二、相关审核、批准程序和意见

1、董事会审议情况

董事会认为：公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。董事会同意本次公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保事项。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日